

3次元積層集積デバイスによる 半導体集積回路技術の進展と展望

Recent Progresses and Developments of
Si Integrated Circuit Technologies with 3D Integrations

半導体デバイスをより大容量・高機能にするために、異種・同種デバイスの2次元集積・3次元積層集積化が進められている。特に3次元積層集積化デバイスを製造するためには、新しい技術導入はもとより、従来技術の延長やそれらを組み合わせながら、新しい発想による技術革新が不可欠である。特に、「ウエハプロセス」と「実装プロセス」という全く異なるテクノロジ文化の擦り合わせが不可欠で、ものづくり立国である日本のお家芸とも言える領域でもある。3次元積層デバイスの最先端技術を共有し、日本の半導体集積回路技術の進展を概観しつつ、今後必要となるデバイス・プロセス技術について議論し、今後の発展を展望する。

日時：2018年9月19日(水) 13:45～17:30

会場：名古屋国際会議場（愛知県名古屋市）

招待講演（敬称略・五十音順）

青柳 昌宏（産総研）

IoT社会へ貢献する3次元集積実装技術

大場 隆之（東工大）

三次元積層プロセスを用いた次世代大規模集積技術

小柳 光正（東北大）

AI時代到来の鍵を握る三次元スーパーチップ；
パラダイムシフトとビジネス戦略

田上 政由（東芝メモリ株）

3次元フラッシュメモリ技術 BiCS FLASH™

藤野 真久（産総研）

3次元積層のための接合技術[仮]

水田 恭平（ソニーセミコンダクタソリューションズ株）

積層CMOSイメージセンサの進化と最新技術



一般講演
数件募集

世話人：中村 誠（富士通研）、高橋 竜太（東京大）、木下 健太郎（東京理大）、
入沢 寿史（産総研）、黒木 伸一郎（広島大）

問い合わせ先：skuroki@hiroshima-u.ac.jp